

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】 第 7 部門第 2 区分
 【発行日】 平成 17 年 9 月 2 日 (2005.9.2)

【公開番号】 特開 2003-124672(P2003-124672A)
 【公開日】 平成 15 年 4 月 25 日 (2003.4.25)
 【出願番号】 特願 2001-317573(P2001-317573)
 【国際特許分類第 7 版】

H 0 5 K 7/20
 G 0 6 F 1/20
 H 0 1 L 23/473

【F I】

H 0 5 K 7/20 M
 H 0 1 L 23/46 Z
 G 0 6 F 1/00 3 6 0 A
 G 0 6 F 1/00 3 6 0 C

【手続補正書】
 【提出日】 平成 17 年 2 月 25 日 (2005.2.25)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】 明細書
 【補正対象項目名】 特許請求の範囲
 【補正方法】 変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

筐体内部に搭載された半導体素子と、この半導体素子と熱的に接続された受熱部材と、この受熱部材からの熱を放熱する放熱部材と、この放熱部材と前記受熱部材との間で液媒体を駆動させる液駆動手段とを備え、この液駆動手段と前記受熱部材と前記放熱部材とが配管で接続された冷却装置を備えた電子機器装置において、

前記筐体内で前記冷却装置の下方に位置し、前記冷却装置からの漏洩液媒体を受けるための液保持部材を設け、前記液保持部材は発熱体で加熱されることを特徴とする電子装置。

【請求項 2】
 請求項 1 記載の電子装置において、
 前記発熱体は、前記筐体内に搭載された電子部品であることを特徴とする電子装置。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】 明細書
 【補正対象項目名】 0 0 0 7
 【補正方法】 変更
 【補正の内容】
 【0 0 0 7】

【課題を解決するための手段】

上記目的は、筐体内部に搭載された半導体素子と、この半導体素子と熱的に接続された受熱部材と、この受熱部材からの熱を放熱する放熱部材と、この放熱部材と前記受熱部材との間で液媒体を駆動させる液駆動手段とを備え、この液駆動手段と前記受熱部材と前記放熱部材とが配管で接続された冷却装置を備えた電子機器装置において、前記筐体内で前記冷却装置の下方に位置し、前記冷却装置からの漏洩液媒体を受けるための液保持部材を設け、前記液保持部材は発熱体で加熱されることにより達成される。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

また、上記目的は、前記発熱体は、前記筐体内に搭載された電子部品であることにより
達成される。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】削除

【補正の内容】